公司代码:688173　　公司简称:希荻微

希荻微电子集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节 管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负、且充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司 2025 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为 -15,498.47 万元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司不满足实施现金分红的前提条件。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	希荻微	688173	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

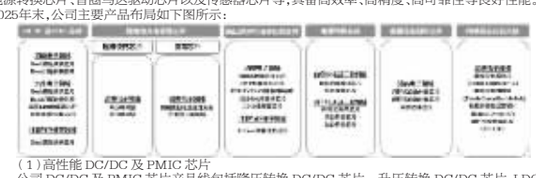
1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢海航	周紫慧
联系地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元(住所申报)	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元(住所申报)
电话	0757-81280550	0757-81280550
传真	0757-86305776	0757-86305776
电子信箱	ir@halomicro.com	ir@halomicro.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为包括电源管理芯片和信号链芯片在内集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品为服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路,现有产品布局覆盖 DC/DC 芯片、锂电池充电管理芯片、高集成度 PMIC 芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片以及传感器芯片等,具备高效率、高精度、高可靠性等良好性能。截至 2025 年末,公司主要产品布局如下图所示:



(1)高性能 DC/DC 及 PMIC 芯片

公司 DC/DC 及 PMIC 芯片产品线包括降压转换 DC/DC 芯片、升压转换 DC/DC 芯片、LDO 稳压器芯片以及高集成度 PMIC 等系列产品,可以应用于消费电子、汽车电子以及计算与存储等领域,实现业内领先的低功耗特性、卓越的负载瞬态响应能力、高效转换效率及高稳定性表现。

在消费电子领域,公司多款消费级 DC/DC 芯片较早进入了 Qualcomm 平台参考设计,各类产品可以为智能手机、可穿戴等移动终端智能电子设备 AP、GPU、LPDDR、WiFi 模组、摄像头模组、OTG 功能、屏幕、硅负极电池等核心单元供电,已广泛应用于三星、小米、vivo、OPPO、联想等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动终端智能电子设备。2025 年,公司推出了多款高效低功耗 DC/DC 降压转换芯片以满足客户需求。

在汽车电子领域,公司车规级芯片达到了 AEC-Q100 标准,其中 DC/DC 芯片进入了 Qualcomm 智能座舱汽车平台参考设计,已实现了向 Joynext、Yura Tech 等全球知名的汽车前装厂商出货,并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。此外,公司高压 LDO 稳压器芯片和高边开关芯片已实现了向国内多家头部客户批量出货,高低边开关芯片的种类不断丰富。报告期内,公司亦推出了车规级 PMIC 芯片产品,可以为摄像头模组内 MCU、SerDes 和图像传感器等提供紧凑、低噪声、高效率的电源管理解决方案。

在计算与存储领域,公司 10-20A 的 POL 芯片产品已经在与下游多家客户进行软硬件适配,部分客户将进入量产爬坡阶段。针对 20-50A 电流范围,公司已有对应的 POL 芯片和功率模组样品,目前正在与目标客户进行初步联调。未来,公司将推出更大电流和更高集成度电源解决方案,以满足数据中心、AI 算力等领域的更高功率需求。

(2)锂电池充电管理芯片

公司锂电池充电管理芯片产品线主要围绕快充芯片和超级快充芯片进行产品布局,细分品类包括线性充电芯片、开关充电芯片、电荷泵充电芯片等系列产品,主要应用于消费电子领域,可以助力移动终端智能电子设备实现高效、快速、安全充电。

中信证券研报显示,凭借充电功率高、系统成本低、兼容性强等优势,电荷泵已成为手机快充的主流方案。公司自主研发的双相充电拓扑结构在大电流充电的情况下实现极小的电压纹波,电荷泵充电管理芯片产品覆盖 2:1、4:1 和 4:2 等多种架构,可以支持 2C-4C 电池快速充电功能,在充电效率、充电功率等方面具有相较海外厂商竞品更良好的表现,且具备更好的电路保护功能和更小的芯片面积。

此外,公司通过围绕市场需求不断推陈出新,帮助客户进一步提升使用体验。报告期内,公司锂电池充电管理芯片已成功导入三星、传音、荣耀、影石等全球知名品牌客户的供应链体系,位列国产电荷泵充电芯片第一梯队供应商。

(3)端口保护及信号切换芯片

公司端口保护及信号切换芯片产品线包括音频和数据开关芯片、SIM 卡电平转换芯片、OVP 负载开关、USB Type-C 端口保护芯片以及 GPIO 拓展器芯片等系列产品,集成了高压负载开关、输出过压保护、输入欠压保护、过温保护、短路 / 过流 / 反向电流保护等功能,赋能移动终端智能电子设备接口转换与安全,广泛应用于以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子领域。

此外,公司推出的 E-Fuses 负载开关芯片系列产品亦可提供全面的保护功能,包括过载保护、过压保护、过温保护和反向电流阻断等,为消费电子、计算与存储等领域提供高可靠供电保障。

(4)音圈马达驱动芯片

公司音圈马达驱动芯片产品线(即智能视觉感知业务),包括开环式自动对焦芯片(如传统音圈电机驱动芯片和双向音圈电机驱动芯片)、闭环式自动对焦芯片以及光学防抖芯片(如 eOIS 芯片、SMA OIS 芯片以及 Folded&C-Zoom OIS 芯片)等系列产品。音圈马达驱动芯片可以精确控制音圈马达的运动,驱动摄像头模组内的镜头完成对焦、防抖等系列机械动作,从而保障图像或视频的清晰度与稳定性。

公司于 2022 年 12 月与全球知名芯片厂商韩国动运达成合作,获得其自动对焦(AF)及光学防抖(OIS)技术在大中华地区的独占使用权。自 2023 年第二季度起,公司以自有品牌全面布局智能视觉感知业务。截至 2025 年末,公司已围绕该产品线搭建了供应链,推动该业务从贸易模式向自产模式转换。同时,公司还组建了专项研发团队,以市场需求为牵引布局下一代产品,通过技术迭代实现产品线在丰富度与性能上的阶梯式升级。

公司与舜宇、欧菲光、丘钛微、立景创新等知名模组厂商建立合作,相关产品已进入 vivo、荣耀、传音、OPPO、小米、联想、科大讯飞、视源股份等品牌客户的供应链体系,广泛应用于智能手机、学习平板、掌上电脑、视频会议设备等各类移动终端设备。在智能手机摄像头核心部件领域,公司音圈马达驱动芯片凭借技术与规模优势,稳居细分市场头部供应商地位;同时正加速布局运动相机、无人机等新兴摄像头应用场景,持续拓展业务边界以巩固技术引领力与市场竞争力。

(5)传感器芯片及其他

公司于 2024 年 8 月完成对韩国芯片设计上市公司 Zinitix(303030.KS)控股权的收购,其产品线包括触摸控制器芯片及模组(Touch Controller IC and Module)、触觉反馈驱动器(Haptic Driver IC)、磁性安全传输芯片(Magnetic Security Transmission IC)等。

Zinitix 核心产品线为触摸控制器芯片(Touch Controller IC)?,它以传感技术为核心构建,能将触摸输入精准转换为电信号,并通过混合传感技术实现更精准的触摸识别,其搭载高速全通道 / 多驱动器架构,可与 AMOLED、LCD 等多种显示面板完美适配,从而满足各类终端电子设备的显示需求。截至 2025 年末,Zinitix 相关产品已导入三星等国际知名品牌的供应链体系,广泛应用于智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑等移动及可穿戴设备,成为提升人机交互体验的关键技术支撑。

2.2 主要经营模式

公司采用 Fabless 经营模式,专注于包括电源管理芯片和信号链芯片在内的模拟集成电路及数模混合集成电路的研发、设计和销售环节,将晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。具体而言,公司在芯片产品的研发完成后,将研发成果图集成电路产品布图交付给专业的晶圆代工厂和封测厂,分别委托其进行晶圆制造和封装测试,再将芯片成品直接或通过经销商销售给下游客户。

在 Fabless 经营模式下,公司有效规避了大规模固定资产投资所带来的财务风险。这使得公司能够更专注于高价值创造的设计开发环节,从而显著提高运行效率,加速新技术和新产品的研发进程,进而提升整体竞争力。在销售环节,公司采用直销和代理经销相结合的销售模式,可有效降低新客户开发的成本,控制应收账款回款风险,并提高公司运作效率和市场响应速度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”,行业代码“I6520”。近年来,AI(人工智能)、5G 通信、物联网、自动驾驶等新兴技术的快速发展,促使集成电路产业不断进行技术创新和产业升级。

1.集成电路行业概况

集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种微型电子器件或部件,其采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。

集成电路产业链主要由“设计——制造——封装测试”三个环节构成,集成电路产业是以技术作为核心驱动因素的产业,在设计环节上技术与资本高度密集,是带动整体产业发展的核心因素,也同样是经济附加值最高的环节。集成电路行业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片,其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的,用于处理数字信号的集成电路芯片,包括微元件,存储器和逻辑芯片;模拟芯片指处理连续性模拟信号的集成电路芯片,包括电源管理芯片和模拟信号处理芯片。其中,电源管理芯片是电子设备中的关键器件,具有较高的技术和渠道壁垒,其性能表现将直接影响电子产品的性能和可靠性。

2.全球模拟芯片的发展情况

由于模拟芯片广泛应用于各种电子产品和系统中,包括消费电子、汽车、通信、计算和存储等,这种广泛、分散的应用为模拟芯片市场提供了多样化的需求来源。模拟芯片因其使用周期长的特性,市场规模呈现稳步扩张的态势。全球 AI 计算基础设施、智能汽车电子与通讯网络升级的范式变革,也推动了模拟芯片需求的增加。

中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国模拟芯片行业市场调研及发展趋势预测报告》显示,2025 年全球模拟芯片市场规模将超过 1,000 亿美元。世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布预测,2025 年全球模拟芯片规模实现 6.7% 的修复性增长,规模达 843.4 亿美元。

3.中国模拟芯片行业的发展情况

集成电路是一个高度全球化的产业,中国集成电路产业虽起步较晚,但凭借巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路行业增长的主要驱动力。中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国模拟芯片行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示,中国模拟芯片市场规模从 2021 年的 1,570 亿元增长至 2024 年的 1,953 亿元,年均复合增长率达 7.5%,2025 年市场规模约 2,203 亿元。中商产业研究院分析师预测,2026 年中国模芯片市场规模将达到 2,451 亿元。

在政策扶持和中美贸易摩擦的大背景下,中国集成电路产品的品质和市场认可度日渐提升,部分本土企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起,整体技术水平和国外设计公司的差距不断缩小,国内企业设计开发的模拟芯片产品在多个应用市场领域逐渐取代国外竞争对手的份额。

据海关总署统计,2025 年中国集成电路出口达 2,019 亿美元,同比增长 26.8%,首次突破 2,000 亿美元大关并创下历史新高。国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》指出,集成电路产业的发展目标是到 2030 年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。主要任务和发展重点是着力发展集成电路设计业,加速发展集成电路制造业,提升先进封装及测试业发展水平,突破集成电路关键装备和材料。

未来,随着消费电子、汽车电子、工业控制、计算与存储等领域的市场需求不断提升,以及国家支持政策的不断提出,芯片的国产化渗透率将进一步提升;而国内本土企业研发产业化加速落地、多元化产品方案日趋成熟,整个市场格局有望进入调整期,中国模拟芯片市场有望开启新一轮的增长。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中信建投研究报告显示,由于模拟芯片产品种类繁多,生命周期长,下游应用高度碎片化,各领域对芯片的性能、功耗、成本要求差异显著,催生了针对特定需求的细分市场,任何单一企业难以全面覆盖。因此行业天然呈现“规模大但集中度低”的特征。全球 CR 10 长期维持在 60%左右,国际领先企业 TI 的市占率最高也不足 20%,难以出现垄断格局。

根据中国半导体行业协会集成电路设计分会数据,截至 2025 年末,我国有约 3,901 家集成电路设计企业,预计有 831 家企业 2025 年销售额超过 1 亿元,占比仅 21.3%,86.5%的企业是人数少于 100 人的小微企业,其 3,375 家。集成电路设计企业数量众多,但大部分盈利能力较低。

公司是国内领先的电源管理及信号链芯片供应商之一,拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队,开发出了一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。2025 年度,公司实现营业总收入 93,943.50 万元,较上年同期上升 72.21%,截至 2026 年 4 月 16 日,营收增速在申万模拟芯片设计 A 股上市公司分类中排名第 2。

在消费电子领域,公司多款产品得到了高通(Qualcomm)、联发科(MTK)等主芯片平台厂商的认可,已广泛应用于三星、vivo、传音、OPPO、小米、荣耀、谷歌、罗技、联想等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备。

在汽车电子领域,公司车规级芯片达到了 AEC-Q100 标准,其中 DC/DC 芯片进入了 Qualcomm 智能座舱汽车平台参考设计,已实现了向 Joynext、Yura Tech 等全球知名的汽车前装厂商出货,并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。此外,公司高压 LDO 稳压器芯片和高边开关芯片已实现了向国内多家头部客户批量出货。

在计算与存储领域,公司 10-20A 的 POL 芯片产品已经在与下游多家客户进行软硬件适配,部分客户将进入量产爬坡阶段。针对 20-50A 电流范围,公司已有对应的 POL 芯片和功率模组样品,目前正在与目标客户进行初步联调。未来,公司将推出更大电流和更高集成度电源解决方案,以满足数据中心、AI 算力等领域的更高功率需求。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

模拟芯片的应用领域非常广泛,中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国模拟芯片行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示,模拟芯片在消费电子领域应用最广,占比 36.97%;其次是泛能源和汽车领域,分别占比 25.96%、19.00%。由于中国模拟芯片供应链发展相对较晚,市场供应仍然严重依赖国际供应商。2024 年模拟芯片国产化率方面,消费电子领域为 40-50%,通讯领域为 20-25%,工业领域为 10-15%,及汽车领域为 5%左右。在国内政策的支持和供应链的共同努力下,本土企业不断攻克关键技术,产品组合日益丰富,在各个细分市场的渗透率不断提高,预计未来几年中国模拟芯片的自给率将快速提升。

模拟集成电路产业将会朝着高效低耗化、集成化以及智能化的趋势发展。目前,电源管理芯片最大的终端市场仍然是手机等消费类电子产品,但由于该市场竞争不断加剧,盈利空间被压缩;而另一方面,汽车电子、高性能计算、工业应用等下游需求不断增长,未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,全球需要的电子设备数量及种类迅速增长,在汽车和工业电源芯片市场应用领域,由于其应用技术要求较高,相应的产品毛利率较高。整体来看,未来电源管理芯片应用领域从低端消费电子市场向高端工业、汽车市场转型将成为行业发展的新趋势。

随着多芯片集成、快速充电和先进电源效率管理的兴起,电源管理芯片的复杂性和规格也不断提升,其单位价值亦随之不断提升,推动了电源管理芯片市场的持续增长。而智能手机轻薄化发展趋势也要求高性能芯片产品进一步降低功耗和缩小器件体积。此外,深度受益于国产替代和光学升级,音圈马达驱动芯片已广泛应用于智能手机尤其是旗舰机型之中。

目前,全球半导体行业呈现结构性复苏态势,希荻微将借助积累的技术优势、客户基础,拓展产品丰富度,对现有产品进一步升级,横向拓展公司产品应用领域,提高公司整体竞争实力。具体体现为充实在电源管理、端口保护和信号切换、音圈马达驱动芯片、传感器芯片等细分领域的芯片产品布局,并有序拓展电源转换产品等领域。此外,公司将在现有消费电子应用领域的基础上,以满足 AEC-Q100 标准的产品为基础,积极布局汽车电子领域,发力计算与存储等领域,不断建立新的收入增长点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,851,966,327.09	1,810,336,339.19	2.30	2,016,373,736.11
归属于上市公司股东的净资产	1,424,570,754.60	1,478,987,485.53	-3.68	1,834,938,568.16
营业收入	939,434,993.17	545,510,607.96	72.21	393,632,323.78
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	934,348,650.09	493,312,371.70	89.40	368,094,018.58
利润总额	-142,818,444.47	-298,673,685.09	不适用	-87,578,756.30
归属于上市公司股东的净利润	-113,918,566.81	-290,597,343.59	不适用	-54,184,639.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,719,680.60	-300,204,783.40	不适用	-187,281,894.01
经营活动产生的现金流量净额	-165,665,147.68	-218,484,467.40	不适用	-245,012,004.35
加权平均净资产收益率(%)	-7.88	-17.59	增加 9.71 个百分点	-2.97
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.74	不适用	-0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.74	不适用	-0.13
研发投入占营业收入的比例(%)	27.80	46.31	减少 18.51 个百分点	60.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	177,679,311.25	288,769,973.46	250,551,174.28	222,434,534.18
归属于上市公司股东的净利润	-27,264,802.83	-17,423,606.29	-31,666,325.09	-37,563,832.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,252,099.94	-18,265,163.89	-32,966,122.94	-39,236,293.83
经营活动产生的现金流量净额	-42,344,944.30	-24,227,437.03	-57,146,991.82	-41,945,774.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,570
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,676
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
戴祖渝	0	93,790,457	22.74	0	无	0	境内自然人
唐姬	0	58,864,836	14.28	0	无	0	境内自然人
重庆唯纯企业管理咨询有限公司	-8,031,191	29,846,925	7.24	0	无	0	境内非国有法人
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳股芯创业投资合伙企业(有限合伙)	-8,766,799	11,748,655	2.85	0	无	0	其他
郝跃国	0	10,153,580	2.46	0	质押	10,150,000	境内自然人
范俊	-3,000,000	10,049,225	2.44	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,114,481	8,719,173	2.11	0	无	0	境外法人
佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)	0	8,686,934	2.11	0	无	0	其他
叶芳丽	0	4,349,742	1.05	0	无	0	境内自然人
广东杭承贸易有限公司	0	4,312,703	1.05	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,戴祖渝和 TAO HAI 签订了表决权委托协议;戴祖渝、唐姬与 TAO HAI 签订了一致行动协议及补充协议,佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)的合伙人为唐姬和 TAO HAI。因戴祖渝于 2025 年 5 月逝世,其持有公司的股份全部由 TAO HAI 继承,TAO HAI 与唐姬于 2025 年 8 月 25 日重新签署了《一致行动协议》,详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于实际控制人重新签署一致行动协议的公告》(公告编号:2025-066),除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

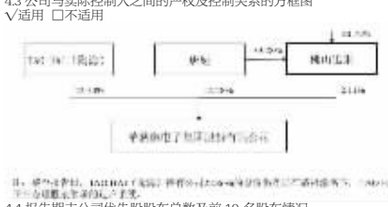
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 93,943.50 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 -11,391.86 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产为 185,196.63 万元,归属母公司所有者的净资产为 142,457.08 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688173　证券简称:希荻微　公告编号:2026-041

希荻微电子集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、情况概述

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司 2025 年度审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -475,713,817.99 元,实收股本为 412,360,270 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》等相关规定,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时,需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

2025 年,国家补贴政策推动了消费电子市场逐步回暖,叠加公司新品持续放量及海外市场拓展深化,公司的营业收入较上年同期实现显著增长,其中音圈马达驱动芯片产品线部分产品已逐步实现自主委外生产,使得该产品线的营收规模明显增长;此外,公司 2024 年 8 月末新增的传感器芯片产品线对公司营收增长亦有所贡献。随着公司总体业务规模的扩大,产品矩阵日益丰富,以及公司对上游供应链的有效整合,公司毛利润较上年同期有所增加。同时,市场逐步回暖、需求趋于稳定,公司存货的减值风险得到有效缓释,本期计提资产减值准备金额较上年同期有所减少。为长远发展,公司持续在汽车、计算和存储等应用领域布局,期间费用尤其是研发投入占营业收入的比重较大,且公司综合毛利率仍有进一步提升空间,使得公司 2025 年仍处于亏损状态。

三、应对措施

2026 年,公司将以战略为引领,密切洞察技术变革与市场需求,主动调整经营策略,通过一系列精准有力的举措,全力保障公司的持续健康发展:

(一)产品与技术升级

在产品性能与技术升级方面,公司将紧密关注快速变化的市场需求,紧跟行业前沿技术趋势,不断在现有产品的基础上进行优化,致力于以更快的速度开发出更高效和低功耗的芯片产品,以满足终端客户日益多样化的应用需求。在拓展产品的应用领域方面,公司将通过加大研发投入,提升产品的性能与可靠性,实现向汽车电子以及计算与存储领域的全面拓展,以扩大产品的下游应用范围。

(二)营销网络建设

随着公司产品线的不断丰富,市场开发、销售推广及售后服务等方面的挑战也日益凸显。为此,公司将通过母子公司战略协同,在现有客户群体的基础上,加强全球范围内的营销和技术支持网络建设,全面整合各类市场资源,提升客户推广和服务能力,以进一步扩大公司产品在国内市场和海外市场的占有率。

(三)管理体系优化

公司将持续优化供应链管理体系,通过母子公司战略协同,重塑供应商管理、物流规划与库存控制机制,消除流程冗余,全面提升供应链响应速度与柔性,并加强对委外生产成本的把控;将质量管控贯穿全链条,完善从难以到售后的全流程品控标准与迭代体系,有效降低质量风险与损失。此外,贯彻落实费用精细化管理,推动经营效率的提升,以实现降本增加,改善公司的盈利能力。

(四)人才团队建设

作为技术密集型行业的一员,公司在人才队伍建设方面给予了高度关注,在境内外建立了多元化的专业团队,积极引进国内外优秀人才。未来,公司将结合长期发展规划,完善人才管理和激励机制,持续培养优秀专业人才,努力打造具备国际化视野的研发和管理团队,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

公司将以国内领先的技术研发实力和深厚的经验积累为依托,积极推动新技术与新产品的快速落地,从而更高效地渗透至品牌终端客户市场,并通过管理体系优化和人才队伍建设,助力公司实现可持续发展。此外,公司将继续积极寻找优质并购标的,通过行业资源的有效整合,快速实现产品品类和市场方向的拓展。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:688173　证券简称:希荻微　公告编号:2026-040

希荻微电子集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 -113,918,566.81 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 -154,984,672.89 元。经董事会决议,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负值,公司不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《希荻微电子集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及公司《未来三年(2024 年 -2026 年)股东分红回报规划》等相关规定,因公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,且充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定的 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 16 日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》,同意公司 2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三年(2024 年 -2026 年)股东分红回报规划》,并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议,并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:688173　证券简称:希荻微

希荻微电子集团股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会与公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会与公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会与公司治理报告全文。

2、本环境、社会与公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688173
公司简称	希荻微
公司名称	希荻微电子集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,为增强报告的可读性,部分内容或数据追溯到以往或后续年度
编制依据	本报告严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关要求,并参考全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南》(GRI Standards)、《联合国可持续发展目标企业行动指南》(SDGs)、国际标准化组织《ISO26000:社会责任指南(2010)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》、中国国家标准 GB/T36001-2015《社会责任报告编写指南》、中国电子工业标准化技术协会 SJ/T16000-2016《电子信息行业社会责任指南》等相关指引进行编制。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 董事会战略与发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 公司每年编制并发布一次年度环境、社会与公司治理(ESG)报告。该报告由董事会战略与发展委员会审议后,最终由公司董事会审定发布。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为 公司建立了《董事会战略与发展委员会实施细则》,明确董事会战略与发展委员会负责对 ESG 工作进行全面领导,包括负责研究、制定公司 ESG 战略规划、战略目标、治理架构及管理制度;评估、审议公司在 ESG 管理方面的策略、风险、执行等工作;审核公司 ESG 报告等。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资人	保障股东权益 获得投资回报 按募集要求信息 持续创造价值 防范经营风险	定期披露经营与财务信息 与投资者定期及日常沟通 股东会 业绩说明会 电话热线 IR邮箱
政府及监管机构	遵守法律法规 环保合规 依法纳税 促进就业 公司治理	日常管理 会议交流 监督检查 公开招聘 调研问卷与资料传递 政府官网政策获取
员工	平等雇佣 工资及福利保障 职业健康及安全 公平的晋升和发展机会 职业培训 人文关怀 反商业贿赂与反贪污	多元化招聘 完善薪酬体系 健全健康安全体系 多元发展路径 职业规划教育与学习交流机会 员工满意度调查 女性员工关注 活动福利 年度述职
供应商、同业及合作伙伴	信守承诺 公平、公正、公开采购 共赢发展 履约交付 行业进步 反商业贿赂与反贪污	供应商管理 阳光采购 信守合同 全流程质量管控 研讨会/展会参与与举办 标准制定 电话或电子信箱沟通反馈
客户	产品研发与技术创新 产品质量管理 信息安全与商业秘密保护